

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	2024年4月26日 JK Capital Management、Marco Polo Pure Asset Management、大家资管、泓德基金、嘉实基金、景林资产、天弘基金、英国巴克莱银行等
时间	2024年4月26日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、CFO、董事会秘书：施文茜
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原股份是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案，以及自主可控的图形处理器 IP、神经网络处理器 IP、视频处理器 IP、数字信号处理器 IP、图像信号

	<p>处理器 IP 和显示处理器 IP 共六类处理器 IP、1,500 多个数模混合 IP 和射频 IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括 IDM、芯片设计公司，以及系统厂商、大型互联网公司。</p> <p>芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验，目前已实现 5nm 系统芯片（SoC）一次流片成功，多个 5nm 一站式服务项目正在执行。根据 IPnest 在 2023 年的统计，从半导体 IP 销售收入角度来看，芯原是中国排名第一、全球排名第七的半导体 IP 授权服务提供商，在全球排名前七的企业中，芯原的 IP 种类排名前二。</p> <p>2024 年第一季度，受下游客户需求等因素影响，公司单季度收入有所波动，营业收入 3.18 亿元，同比下降 41.02%。目前公司在手订单充足，截至 2024 年一季度末，公司在手订单金额为 22.88 亿元，较 2023 年末增长 11.03%。2023 年末在手订单中，公司预计一年内转化的金额约 18.07 亿元，占比近 90%，2024 年二季度起，公司在手订单将较大规模地转化为收入。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题: 请问公司看待 Chiplet 技术和已有业务的协同? 公司在这个领域的研发布局有哪些?</p> <p>回复: 芯原拥有丰富的处理器 IP, 以及领先的芯片设计能力, 加上我们与全球主流的封装测试厂商、芯片制造厂商都建立了长久的合作关系, 近几年来一直在致力于 Chiplet 技术和产业的推进, 通过“IP 芯片化, IP as a Chiplet”和“芯片平台化, Chiplet as a Platform”, 来促进 Chiplet 的产业化。Chiplet 技术将提高公司的 IP 复用性, 增强业务间协同, 增加设计服务的附加值, 拓宽业务市场空间; 进一步降低客户的设计时间、成本和风险, 提高芯原的服务质量和效率, 更深度绑定客户; 并进一步提高</p>

公司盈利能力，实现竞争力升维，将芯原的 IP 授权业务和一站式芯片定制服务业务推上新的高度。

公司根据具体应用需求，正在持续推进关键功能模块 Chiplet、Die-to-Die 接口、Chiplet 芯片架构、先进封装技术的研发工作。同时，芯原还将进一步迭代并推广采用 Chiplet 架构所设计的高端应用处理器平台。此外，公司还基于自有的通用图形处理器（GPGPU）IP、NPU IP、UCIe 物理层（PHY）等技术，正在积极推进面向 AIGC 和汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）应用、采用 Chiplet 架构的芯片设计平台的研发。在 2023 年，芯原已经和客户开展合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款自有处理器 IP，帮助客户部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。

问题：请问公司的一站式芯片定制业务如何体现规模效应，公司如何展望量产业务的成长？

回复：公司的一站式芯片定制服务包括芯片设计业务和芯片量产业务，主要面向消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等广泛应用市场。在芯片设计阶段，公司需要投入研发人员进行项目设计；但项目进入量产阶段后，公司量产业务面对市场风险和库存风险压力较小，仅需以相对稳定的量产业务团队管理日益增长的量产业务，具有可规模化优势。近五年来，公司量产业务收入年复合增长率约 20%；截至 2024 年一季度末，公司量产业务在手订单金额为 7.67 亿元，较 2023 年末增长约 23%，未来，公司在手订单将不断转化为收入，为量产业务的持续性奠定了坚实基础。

问题：请问芯原的商业模式和行业内芯片设计类公司有什么区别？

回复：公司致力于打造集成电路领域的技术创新平台，通过积累的芯

片定制技术和半导体 IP 技术为客户提供一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务，与芯片设计公司经营模式有一定差异。行业内芯片设计公司主要以设计并销售自有品牌芯片产品而开展业务运营，芯原的商业模式是给客户提供服务，而不是销售自有产品，这种经营模式使得公司集中力量于自身最为擅长的技术授权和研发平台输出，市场风险和库存风险压力较小。

问题：请问公司研发人员按照部门是如何配置的？

回复：公司专注的半导体 IP 技术和芯片定制技术处于集成电路设计行业上游，亦是集成电路设计行业技术含量较高的知识产权密集型领域，具有研发投入大、研发周期长的特征，公司始终重视研发人才的引进与培养，根据发展战略进行研发布局，以稳定、合理的速度来扩充公司的研发团队，打造了较高的人才壁垒。截至 2023 年末，公司拥有研发人员 1,662 人，占员工总人数的 89.16%，公司硕士及以上文凭的研发人员占比达 87.55%，中国大陆地区具有十年以上工龄的研发人员占比为 28.64%。按照研发部门划分来看，公司 IP 事业部研发人员约 700 人左右，芯片定制平台事业部的研发人员约 900 人左右。